

## 北京耐威科技股份有限公司

### 关于控股子公司第三代半导体材料制造项目（一期）投产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司（以下简称“聚能晶源”）投资建设的第三代半导体材料制造项目（一期）已达到投产条件，于2019年9月10日正式投产。聚能晶源于同日举办了“8英寸GaN外延材料项目投产暨产品发布仪式”。

聚能晶源位于青岛市即墨区，主要从事半导体材料，尤其是氮化镓(GaN)外延材料的设计、开发和生产。本项目已投资5,200万元人民币，设计产能为年产1万片GaN外延晶圆，既可生产提供标准结构的GaN外延晶圆，也可根据客户需求开发、量产定制化外延晶圆。本项目的投产将有利于聚能晶源正式进入并不断开拓第三代半导体材料市场，同时有利于公司GaN功率与微波器件设计开发业务的发展，最终增强公司在第三代半导体及物联网领域的综合竞争实力。

公司GaN业务的发展需要进一步的资金、人员等资源的持续投入，聚能晶源的未来运营可能受到市场竞争、经营管理等诸多风险因素的影响，客户订单的增长及未来销售情况均存在不确定性，项目产能的释放也需要客观过程。聚能晶源将根据客户需求合理安排产能计划，预计本项目的投产将对公司未来的经营成果产生积极影响，但预计在短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年9月10日